

证券代码：300476

证券简称：胜宏科技

胜宏科技(惠州)股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 电话会议 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	健顺投资、盘京投资、旺旺投资、石锋投资、汐泰投资、孝庸资产、巨子投资、歌汝投资、民生证券、榕湖投资、汇添富基金、富国基金、益恒投资、富途控股、东海证券、拓聚投资、天风证券、磐泽资产、青云投资、浙商证券、中信证券、金石投资、中安汇富、银叶投资、拾贝投资、和谐汇一、福泽源基金、多和美投资、合熙智远、青骊投资、纽富斯投资、UBS、Wellington Management、Welight Assets、Toroa Management、Emerald Wealth Partners、Dodge & Cox、Corbets Capital、Causeway Capital、Artisan Partners、Artemis Investment Management等62位机构投资者及个人投资者。
时间	2025年09月11日-2025年09月12日
地点	胜宏科技惠州总部、泰国孙公司
上市公司接待人员姓名	1、董事长：陈涛 2、投资者关系经理：王慧珍
投资者关系活动主要内容介绍	一、投资者参观公司展厅、生产车间 二、董事长陈涛先生介绍公司基本情况 1、AI 带来的行业机遇 2024 年以来，AI 科技革命席卷全球，推动算力、高速网络通信、新能源汽车、智能驾驶等下游领域高速发展，PCB 行业进入新一轮增长周期，已成为不可逆转的确定性

	趋势。 在 AI 时代，高多层与高阶 HDI 已成为 PCB 技术刚需，Prismark 预计 AI PCB 五年复合增长率将达到 20%。未来五年，在人工智能的引领下，AI 算力、AI 服务器、人形机器人、无人驾驶、AI 手机、AI PC 领域高速发展，带动 24 层以上乃至 100+层高多层、24 层六阶以上高阶 HDI 需求大幅增长，PCB 价值量大幅提升。 2、公司领先优势 （1）战略优势 公司坚定“拥抱 AI，奔向未来”的核心发展理念，紧抓 AI 算力技术革新与数据中心升级浪潮带来的历史新机遇，成功抢占市场先机。未来，公司将继续紧密围绕客户进行技术创新与产品布局，与客户共成长，把握未来技术和产品风向，为客户提供更优的技术和更好的品质服务，不断提升核心竞争力。 （2）技术优势 公司凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，深度参与核心客户项目合作研发，提前迈入专有技术积累关键期，建立技术壁垒，领先市场量产技术 2-3 年。公司在 AI 算力、AI 服务器领域技术全球领先。 （3）品质优势 公司产品稳定、可靠性强，高阶 HDI 及高多层良率均为行业较高水平。AI 技术在全流程各检测站分别实现全覆盖，可自动判别、自动筛选、自动统计、自动分析，确保不良品零流出。通过 AI 历史数据建档，精准分析高频问题发生环节，推动产品不良持续改善，实现零缺陷生
--	---

	产目标。 （4）产能优势 公司现有产能涵盖广东、湖南、泰国、马来西亚等多个地区，其中，惠州总部已成为全球规模最大的单体 PCB 生产基地，全球化交付、服务能力行业领先。未来，随着惠州厂房四、泰国工厂和越南工厂等项目陆续投产爬坡，公司的高端产品产能将进一步提高，能够更好地满足客户全球化交付需求。 （5）客户优势 凭借领先的研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，深度参与国际头部大客户新产品预研，提前 2-3 年开展相关技术开发储备，从产品规划到技术能力提升，再到扩产计划，全程跟踪服务客户，已形成较强的技术壁垒与客户粘性，市场竞争力强劲，构建了深厚的护城河。 （6）管理层及文化优势 公司创始人兼董事长陈涛先生是 PCB 行业公认的技术专家和领导者，带领公司精准把握产业趋势，深挖下游行业需求迭代趋势，推动公司高速发展。在董事长的带领下，公司组建了一支具备强大技术专长，经验丰富，兼具国际视野的高级管理团队。同时，公司坚持人才驱动战略，构建全球化人才引进与培养体系，围绕 AI 算力等核心领域定向引进高端管理及技术人才。 3、下游供需格局 从整个供需结构上看，行业对高端产能的需求持续增加，高端产品的供给仍然处于相对紧张的状态。公司同时在研发方面进行多客户的适配，这一适配有利于公司未来进行客户和订单的选择，公司会考虑订单规模、确定性程
--	--

	度、盈利能力等因素进行产能分配。 4、PCB 未来发展趋势 在 AI 领域，随着算力需求持续提升，行业发展趋势是不断降低单位算力能耗、提升算力密度和电性能能力，具体体现为：信号传输带宽持续升级，材料等级不断提高；高多层板、高阶 HDI 的层数、阶数不断增加，板厚进一步增厚，电路密度也更精细。这种变化导致 PCB 制造工艺要求大幅提高，加大了对产能的消耗，同时也使得产值提升，ASP 发生成倍甚至呈指数级别的增长。 三、互动交流环节具体情况如下： 1、目前公司持续进行产能扩张，如何看待下游客户需求的增长？ 答：随着全球通用人工智能技术加速演进，人工智能训练和推理需求持续扩大，AI 算力、AI 服务器的需求迅速增长，对 PCB 的需求量大且要求高。从发展趋势来看，信号传输带宽将持续升级，材料等级不断提高，高多层板、高阶 HDI 的层数、阶数不断增加，这会进一步消耗高端产能，有效产出面积（平米数）呈减少趋势。当然随之而来的是公司产品价值量、产值能力在不断提升。从中期来看，高端产品的供给仍将处于相对紧张的状态。 PCB 属于高度定制化的产品，要基于明确的订单需求及未来技术方向才能更精准更有效地扩产，公司目前的产能规划主要基于下游客户需求和订单情况的预测。公司在服务好大客户的同时，也在持续推进与其他全球头部科技企业的合作，提前进行技术储备与高端产能的准备。 2、公司全球化布局目前进展如何？
--	--

	答：公司通过境内外业务拓展，坚定推进国际化战略，依托境内外自建工厂与并购整合双轮驱动模式，已构建起覆盖高端制造、客户服务及区域协同的全球化运营网络。 国内产线以惠州总部为核心枢纽，构建起“研发设计—先进制造—技术服务”一体化运营体系，重点布局高多层 PCB、高阶 HDI 及其他创新产品的研发与生产，产品矩阵可全面覆盖 AI 算力卡、AI 服务器、高速交换机、光模块等人工智能计算硬件所需的高性能 PCB。海外市场方面，公司正在泰国、越南投资建设多条生产线，进一步扩充高多层、高阶 HDI 的高端产能，建设完成之后，能够有效满足全球客户的多元化需求，全球交付能力将大幅提升。 目前，泰国工厂一期升级改造已于今年 3 月完成，二期升级改造也已基本收尾。近期，北美科技大客户已陆续启动工厂审核，部分客户已启动泰国工厂的产品导入流程，相关订单已进入排产阶段。预计今年下半年，泰国工厂的产品结构将实现显著优化，高端产品有望实现规模化量产。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2025年09月12日